

深圳市杰普特光电股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发展前景的信心，围绕聚焦主业、持续完善公司治理等方面，于 2025 年 4 月制定并积极贯彻落实《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，围绕经营质效、公司治理、信息披露及投资者回报等方面持续开展工作。

为进一步提升公司质量和投资价值，公司结合实际情况，编制了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司将持续优化经营管理效能，提升治理水平和规范运作能力，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益。具体内容如下：

一、持续发展核心业务，加大研发投入

公司专注激光器、激光/光学智能装备及光纤器件的研发生产，拥有 600 余项知识产权（含 100 余项发明专利），构建“光+AI”创新生态。依托自主激光技术，布局消费电子、数据中心、通信基建、新能源车、锂电及 AR/VR 等领域，提供全场景光学解决方案。以“激光+”战略推动产业升级，持续赋能智能制造。

2025 年，宏观经济整体处于复杂多变的背景下，公司凭借前瞻性的战略布局以及高效的执行能力实现了经营业绩的快速增长。2025 年，公司实现营业收入 20.74 亿元，较去年同期增长 42.66%；归属上市公司股东的净利润 27,878.86 万元，较去年同期增长 110.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,010.04 万元，较去年同期增长 155.86%。

2026 年，公司将继续聚焦主营业务，围绕既定发展战略，紧跟激光加工行业、光学检测行业以及光通讯行业的快速发展机遇，实现可持续发展。具体措施如下：

（一）在锂电激光加工方面，公司持续关注锂电行业最新动向，积极配合客户研发新材料、新工艺所需的激光器产品，确保公司产品能够持续满足客户需求。2025年，公司持续向客户交付500瓦MOPA脉冲激光器产品。2026年，公司将持续为客户提供高可靠性激光器产品，为客户确保生产效率以及生产良率。

（二）激光作为加工基础工具能够适用的加工场景非常多。消费级的激光雕刻应用也是公司激光器产品能够服务的应用场景。公司自主研发的光纤激光器能够很好地增强上一代消费级激光雕刻机在金属雕刻方面的不足。增加能够加工的金属品类、增加加工工艺以及提高加工效率，这些特点让我们的激光器产品获得了客户的认可。

（三）在被动元器件方面，公司在前代激光调阻机产品取得市场充分认可后着手开发第二代产品。公司预计新一代激光调阻机可进一步提升调阻效率与精度，满足客户对生产效率与良率更高追求。2025年公司自行研发的电容测试分选机在客户现场获得客户初步认可。2026年将持续完善第二代激光调阻机产品以及不断完善电容测试分选机产品，为行业贡献更具加工效率的生产设备。

（四）光电模组检测方面，公司持续配合客户研发、完善多款XR相关检测设备。目前多个项目为独家供应。另一方面，得益于客户在国内快速铺设手机摄像头生产产线，公司手机摄像头相关检测设备相关订单与收入增长迅速。2024年公司持续获得手机摄像头相关检测设备相关项目订单，部分2024年下半年获取订单需在2025年陆续完成交付验收。2025年公司完成了手机摄像头相关检测设备订单，同时开始获得新一代VCSEL模组检测设备订单。2026年将持续在光电有源器件检测上持续深耕，为客户提供更高检测效率的解决方案。

（五）公司激光微纳加工设备主要得益于公司长期激光技术积累、与客户长期合作获得客户认可以及客户所需加工设备有所放量等原因。目前双方合作项目仍在增加，主要围绕其手机、手表、电脑等消费电子产品做激光精密加工应用。2025年为客户定制化研发的手表产品激光加工设备加工效果优异，获得客户多维度认可。2026年公司将持续跟踪客户最新激光微纳加工需求，为客户提供更具性价比的定制化激光加工解决方案。

（六）在PCB行业为印刷电路板打孔的设备当中，打通孔的设备大多为刀

具打孔——接触式加工方式，在打盲孔领域基本由进口激光打孔设备垄断整个行业。公司研制的 FPCB 激光钻孔机可用于柔性电路板打通孔与打盲孔的加工需求。相较于刀具打孔的方式，激光打孔没有耗材，进一步降低使用者长期使用成本。另外激光作为非接触式加工方式未来还有进一步提升加工精度的可能性。相较于进口打盲孔设备，公司的产品更具有性价比，加之公司激光加工设备多采用公司自主研发的激光光源，能够进一步提升产品稳定性以及产品加工良率。上述参数的提升在工业加工领域意味着使用者成本的进一步降低。2025 年 FPCB 激光钻孔机已开始获得国内行业头部客户订单。2026 年公司将持续推动产品创新，研发能够适用于下一代 M9 电路板的激光钻孔机。公司将致力推进 PCB 激光钻孔设备领域更多技术替代及国产替代。

（七）2025 年公司在光连接/光通讯领域加速布局，持续聚焦未来光连接解决方案，面对数据中心、云计算、人工智能行业的旺盛需求，推出了 MPO 光纤连接器、光纤阵列单元（FAU）等产品。上述产品均在数据中心的有着不可替代的地位。而且随着未来 CPO 技术的普及以及 AI 技术的普及，数据中心的数据计算量、数据交换量将会快速提升。MPO、FAU 模块都需要根据新技术、新需求来提升自身通道数量，来提升整体数据中心处理数据的能力。2026 年公司将投入较大精力在 MPO 产品扩产上，确保公司交付能力能够满足现有客户的需求；同时公司将在 FAU 生产方面加入更多自动化生产、检测设备，进一步提升生产效率。

二、持续投入研发资源，保持公司科技创新活力

作为科创型企业，科技创新是公司的立身之本。2025 年公司投入研发费用 1.75 亿元，较 2024 年增长 4.60%。公司持续投入研发在激光器新产品开发、现有产品优化以及定制化智能装备产品的研发中。

公司为消费级激光雕刻机定向研发的脉冲光纤激光器助力客户产品适用更多金属材料激光加工工艺。在动力电池生产方面，在客户订单有较大幅度增长的情况下，公司保证了激光器的供应能力以及产品的稳定性。

在智能装备方面，公司自主研发的新一代 VCSEL 模组检测设备将原本 VCSEL 模组组装测试后段制程中的两台设备合并为一台设备，通过创新的角度

摆台设计方案、定制供电模块及上下料方式设计大幅提升该检测工序的效率及良率，获得客户高度认可。FPC 方面，公司自主研发并推出了完全自主可控的软性电路板激光微孔加工设备——黄金枪，该设备使用公司自主研发的纳秒紫外激光器，可实现盲孔加工的工艺表现。同时公司积极推进新品类激光微孔加工设备的研发。公司研发的 MLCC 高速测试分选机实现关键测试仪表模块全链路自主研发；8 条独立测试轨道同步运行（CD+DF 模式）；对比传统 8 轨设备，效率提升 30%，具备产能爬坡无忧等特点。

公司与新加坡雨树光科私人有限公司合作研发的新一代硅光晶圆级测试系统将实现以下关键技术突破：支持栅耦与边耦两种主流光耦合方式，覆盖更多芯片类型；栅耦耦合自动对准时间短，显著提升测试节拍；晶圆平台定位精度高，满足高精度测试需求；兼容不同尺寸晶圆，支持多种封装形式的快速切换与测试流程复用，适应多元化生产场景；支持与 MES 等工厂系统无缝对接，可进行测试流程配置、实时状态监控和数据追溯。新一代产品将有效破解当前国内硅光芯片测试环节中的成本与效率瓶颈，支撑大规模量产需求。

2025 年公司在光连接/光通讯领域加速布局，持续聚焦未来光连接解决方案，面对数据中心、云计算、人工智能行业的旺盛需求，推出了 MPO 光纤连接器、光纤阵列单元（FAU）等产品。2025 年公司实现了 MPO 模块的快速扩产以及交付，获得客户在交付能力以及交付质量上的肯定。2026 年公司发挥在精密光学检测与自动化系统的深厚优势，为 FAU 制程定制高精度、高效率的自动化解决方案，提升良率与效率，巩固核心竞争力。目前公司已研发出多个工艺段的自动化加工、检测设备，后续将持续优化上述设备，进一步提升生产自动化程度。

截至 2025 年 12 月底，公司已申请知识产权 865 项，其中发明专利 317 项；实用新型专利 311 项；外观设计专利 45 项；软件著作权 191 项；其他知识产权 1 项。截至 2025 年 12 月底，公司已授权知识产权 667 项，其中发明专利 144 项；实用新型专利 286 项；外观设计专利 45 项；软件著作权 191 项；其他知识产权 1 项。

2026 年，公司将保持现有研发规模，持续投入研发力量，持续保持较高研发投入水平，提升核心技术竞争力。

公司对创新过程中产生的知识产权实施全面保护，对知识产权风险进行规避和化解，保护自主知识产权，尊重他人知识产权，致力于成为符合国际标准的全球化企业。

三、完善公司治理，夯实高质量发展基石

完善的公司治理体系是企业高质量发展的基石。公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2026年，公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，主要举措包括：

（一）紧跟政策步伐，确保制度合规高效

2025年，公司围绕法律、行政法规、证监会部门规章以及交易所业务规则的最新要求，及时根据最新法律法规和相关规定，结合公司实际，系统梳理公司原有制度，进行全面的修订、补充和完善。完成董事会换届选举的同时根据《中华人民共和国公司法》规定修订了《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》，公司取消设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相关制度同步废止，并根据修订后的《公司章程》选举了职工代表董事。

2026年，公司将秉持前瞻性和专业性的发展理念，持续完善内部控制体系，优化治理架构，以应对复杂多变的全球市场环境和加速迭代的技术需求。公司依据《公司章程》及相关法律法规，结合自身实际，全面建立健全内部控制制度，确保董事会及管理层高效运作，科学决策。同时，随着新《公司法》引入职工董事要求，依法民主推选职工董事，完成治理架构迭代，借力职工董事制度，实现治理效能与市场竞争力的同步跃升。董事会及高管团队的结构优化精简，旨在构建更敏捷的决策机制，通过权责聚焦和成本效能提升，确保战略目标的高效落地。

（二）加强“关键少数”的规范运作意识及提升履职能力

2025年，公司共召开股东会会议2次，董事会会议10次、独立董事专门会议2次、审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议6次、提名委员会会议4次、战略与ESG管理委员会会议1次。公司通过高效有序的会议机制，充分发

挥“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续提升规范运作水平和科学决策能力，切实保障全体股东的合法权益。同时，公司积极组织董事、高级管理人员参加各类培训，及时传递监管政策动态，不断提升履职能力，强化合规意识，推动公司治理水平持续优化。

2026年，公司将继续秉持“重视‘关键少数’、推动公司可持续发展”的理念，为确保公司“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职能力和合规知识储备，进而提升公司整体的规范运作水平，一方面，公司将及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，全年不少于12次；另一方面，组织“关键少数”进行线上、线下学习，包括充分借助证监会、上海证券交易所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台等资源，就公司合规运作知识进行有针对性的学习，每人全年参加培训不少于1次。

四、重视对投资者的合理投资回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，自上市后持续分红，近三年每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的30%。

2025年3月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本95,049,423股为基数，扣减回购专用账户的股数250,404股，拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），共计拟分配现金39,815,587.98元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.01%。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,545,784.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和股份回购金额合计60,361,372.14元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.49%。2025年6月，公司已完成2024年年度现金分红相关工作。

2026年，公司将继续践行稳健的分红政策，坚持公司可持续发展与股东回报并重的利润分配政策。公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡。长期来看，随着公司在激光领域布局逐步完善，公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

五、提高信息披露质量，畅通投资者交流渠道

公司严格执行上市公司信息披露相关法律法规，按照真实、准确、完整、及时、公平的基本原则履行信息披露义务，保证投资者充分了解公司重大信息。2026年公司将进一步提升信息披露质量，除高质量完成日常信息披露工作外，还将考虑到信息披露资料的可读性和有效性，定期报告披露后将采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式对公告进行解读，充分利用图表可视化形式，向投资者展示公司经营、产品、技术等情况，让投资者更简单易懂地了解公司。

2025年，公司召开2次业绩说明会，分别是2024年度暨2025年第一季度业绩说明会与2025年半年度暨第三季度业绩说明会。2026年，公司计划召开3次业绩说明会，并通过投资者热线、IR邮箱、上证e互动、券商策略会、公司官网、微信公众号、视频号等多种渠道与投资者建立密切联系，积极回复投资者问题。

此外，公司还将邀请投资者参与投资者接待日等活动，邀请投资者来线下面对面沟通交流，加深公司与投资者之间的联系，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者。维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2026年3月27日